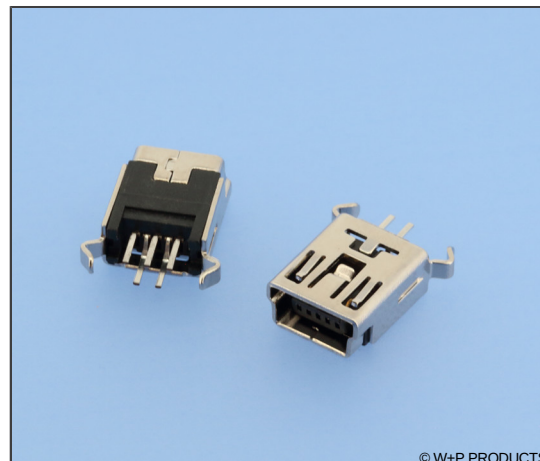


Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchsen gerade

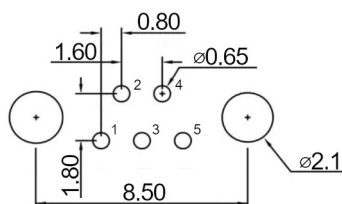
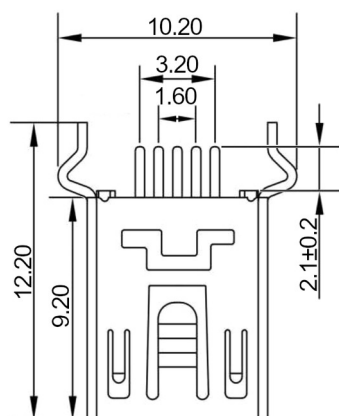
Mini-USB Connectors, Type B, Jacks Straight

Technische Daten / Technical Data

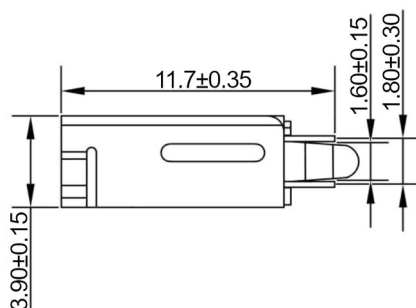
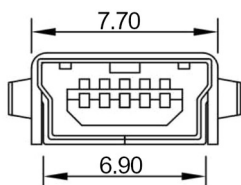
Gehäuse	Messing, vernickelt
Shell	Nickel plated brass
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	none
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ
Contact Resistance	< 50 mΩ
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Insulation Resistance	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit	300 V AC
Test Voltage	300 V AC
Nennspannung	30 V RMS
Voltage Rating	30 V RMS
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	0 °C ... +50 °C
Temperature Range	0 °C ... +50 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren 260 °C / 10 sec.
Processing	Reflow soldering 260 °C / 10 sec.



© W+P PRODUCTS



Recommended PCB Layout



Series	Type	Contacts	Version	Plating*
835	2	05	1	80
	2 Type B (female)		1 Eingang oben Top entry	60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0; C=2,1mm)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

